

2026 年 3 月期 決算説明会 Q&A

●第 1 回：2026 年 5 月 14 日（Q1～Q13）

●第 2 回：2025 年 6 月 8 日（Q14～Q16）

第 1 回 2026 年 5 月 14 日（Q1～Q13）		
Q1	SPE	CY2026 年中国 WFE の考え方は？また御社が WFE 成長をアウトパフォームする場合、どのアプリケーションが牽引するか？
A1		・中国 WFE 成長はフラットの見込み。一方、中国以外の地域の売上が伸びるため、当社の中国向け売上比率は相対的に下がる見込み。 ・WFE 成長シナリオでは当社が得意な先端ロジック・ファウンドリー分野が大きく伸びると見ており、この分野がアウトパフォーム要因となり得ると考える。
Q2	SPE	2027 年 3 月期、下期に売上が伸びる想定だが、どのアプリケーションや地域が勢いを増すのか？
A2		AI 向けの先端ロジック・ファウンドリー、メモリー（生産能力増強中）が、下期売上増のメインドライバーとなる。
Q3	SPE	2027 年 3 月期、売上 6,000 億円の計画は現状の生産能力上限に近いと認識しているが、その後の設備増強の計画は既にお持ちか？
A3		市場の伸びに対応するべく（当社の）生産能力を増強、整備中。（業界団体の）SEMI や SEAJ の長期見込みをベースに、アウトパフォームする分量+ α 程度を生産出来る体制構築を進めていく。
Q4	SPE	製品シェアについて、CY2024 年比で低下の要因は？挽回する場合の目標値は？
A4		・POR を競合に奪われたわけではなく、競合の POR 領域が伸びたと認識。ただし、当社は競合の POR を一部奪取済で、お客様の次の投資タイミングでシェアを上げられると見込んでいる。 ・当社の得意分野もプロセスとして伸びており、回復する自信はある。
Q5	SPE	収益性の考え方。4Q の 30%超の営業利益率の背景は？また、新年度（2027 年 3 月期）は売上伸長の計画に対し、営業利益率は前年と同水準の背景は？
A5		・前期 4Q 営業利益率は、売上の集中と（収益性が高い）ポストセールスが増えたことにより高い利益率を出せた。 ・2027 年 3 月期の営業利益率予想は、（中期経営計画の方針に沿って）成長投資による固定費増加と、ポストセールスよりも装置売上がさらに伸びることが要因（ミックスの変動）。
Q6	SPE	下期売上予想が 3,400 億円は、通期に換算すると 7,000 億円弱になるが、この先、さらに需要が増えた場合の生産能力は問題ないか？ また、中東情勢で、足元で部材不足の影響はないか？
A6		・生産能力は、想定比プラスαの余裕を持っているので問題ない。 ・部材調達は、今年度分は確保可能。中東情勢がさらに長引けば、来年分は要検討。予想は大変難しいが、日々シミュレーションしつつ、状況を注視中。

Q7	SPE	2027 年 3 月期 320 億円の固定費増のうち、開発で 60 億円（増加分）を除く、固定費（260 億）の内容は？
A7		減価償却費、増産・成長に向けた人件費の増加。売上増に伴うフィールドサービス人員増も計画。ATCA の研究開発と設備投資の賃借料も影響。
Q8	SPE	今下期向けの受注はどの程度確定しているか？
A8		現状の受注・引き合い強く、3Q までは顔ぶれなども見えてつつある。
Q9	SPE	米国の MATCH 法が成立した場合の業績への影響は？
A9		影響度を測ることは難しいが、中国向け売上の 10～15%程度の影響があるのではと想定。引き続き、業界団体などから情報収集し、影響額算定の試算を継続する。
Q10	SPE	原材料費の高騰に関し、同業他社が製品の値上げを示唆、御社の方針は？
A10		原料費高騰を踏まえ、お客様と丁寧な価格交渉でコスト転嫁を目指す。過去の価格改定の実績も踏まえ、（当社の）営業利益率が悪化しないよう取り組む。
Q11	SPE	直近 3 カ月での受注状況の変化は？ 尚早かもしれないが、2027 年以降のモメンタムは？
A11		・ 昨年 11 月ぐらいから AI 普及に向けてサーバー用半導体、それをサポートする HBM への受注が高まってきた。大手ロジック・ファウンドリー、メモリー各社が増産体制に入られ、市場が大きく変動。 ・ 2027 年以降も、この成長トレンドは続くと見込む（2026 年に生産しきれないデバイスへの投資に繋がる）。地政学的なリスク要因が解消すれば、需要は旺盛、見通しに懸念はない。
Q12	SPE	アドバンスドパッケージビジネスの見通しは？
A12		市場全体の伸び同様、20%程度の成長を見込む。お客様による当社装置の採用は順調。販売拡大の進捗については、2027 年 3 月期後半にはもう少し詳細をお伝えできる見込み。
Q13	SPE	プレゼン資料には、「中国 WFE 見通し、メモリー投資堅調」とあるが、3Q 決算発表時になくて、今回追加された理由は？ DRAM か NAND か？
A13		・ 従来、中国メモリーは汎用品が多かったが、最近は AI 開発も進み、HBM など高性能メモリーの需要が増えているという状況を追記した。 ・ 高性能領域で強みをもつ当社にとっても、有利な潮目が変わってきた。
第 2 回 2026 年 6 月 8 日（Q14～Q16）		
Q14	GA	2026 年 3 月期の着地の評価、および今期見通しは？
A14		・ 新機種売上が奏功し増収なるも、米国関税影響にて減益。2027 年 3 月期も堅調な装置売上を見込む。関税による利益マイナス影響は極力価格転嫁にて影響を減らしたい。 ・ 関税還付の動きについては、現地情勢の情報を収集の上、対応を検討中。
Q15	FT/HD	2026 年 3 月期の着地の評価、および今期見通しは？
A15		・ 好調な設備投資、売価改善と顧客ミックス、効果的な原価管理の取り組みが奏功し大幅増収増益。2027 年 3 月期は、立ち上がりつつあるアドバンスドパッケージ事業を統合（アドバンスドパッケージ主力製品郡は従前より FT が生産）。開発/製造販売のシナジーに期待も、当面は営業利益率低下を見込む。 ・ アドバンスドパッケージビジネスは 2030 年に装置群全体（連結）で 400～500 億円売上規模に育てていきたい。

Q16	PE	・ 2026 年 3 月期の着地の評価、および今期見通しは？ ・ アドバンスドパッケージの直接描画装置とのビジネス分けは？
A16		・ 想定通り 4Q より売上、営業利益回復し、通期では黒字で着地。2027 年 3 月期は、4Q から回復してきた韓国、中国でのパッケージ向け投資の継続を背景に、増収増益を見込む。 ・ PE の露光機はミドルハイ～ハイエンドパッケージ市場向け、LeVina はアドバンスドパッケージ市場でのビジネス拡大を目指す。アドバンスドパッケージ向け直接描画露光機 (LeVina) は PE で培った技術を展開して開発。当社が長年培った直接描画の様々な技術を掛け合わせ、パッケージ市場での売上拡大を目指す。

HD: ホールディングス、SPE: 半導体製造装置事業、GA: グラフィックアーツ機器事業、
FT: ディスプレー製造装置および成膜装置事業、PE: プリント基板関連機器事業